

第3回 「電子デバイスフォーラム京都」

「次世代自動車」「電子部品から見たIoT/M2M機器」
「次世代成長アプリとそれに搭載される電子デバイス」の
将来性を徹底追求

■会期：2016年11月1日(火) 10:00～11月2日(水) 17:00
■会場：京都リサーチパーク (KRP) 東地区1号館、西地区4号館など

【開催概要】

■開催日時

日時：2016年11月1日(火)10:00～11月2日(水)17:00

■場所：京都リサーチパーク (KRP)

東地区1号館4階：サイエンスホール、AV会議室、中会議室、小会議室、ホワイエ
KLSTIC 2階：イノベーションルーム、KLSTIC 1階：アトリウム
西地区4号館B1F：バズホール

【プログラム】(テーマ名等は今後変更の可能性があります)

■「挨拶・基調講演」(11月1日午前)

ご挨拶：京都府・京都市
基調講演：

「IoT機器を支える超小型電子部品」岩坪 浩 (株式会社 村田製作所 取締役常務執行役員 技術・事業開発本部 本部長)

「IoT革命をもたらす電子デバイスの新世界～メモリー半導体とセンサーが急上昇～」泉谷 渉 (株式会社 産業タイムズ社 代表取締役社長)

「New Era of Electrification and Vehicle Intelligence」久村 春芳 (日産自動車株式会社 フェロー)

■「次世代自動車」(11月1日午後、2日午前、午後)

「ここまで来たADAS/自動運転」、「次世代電動車を導く先端パワー半導体」、「自動車が牽引する次世代実装技術」

■「電子部品から見た最新IoT/M2M機器」(11月1日午後、2日午前、午後)

「IoT/M2M機器とそれを支える電子部品」、「センシング技術」、「先端材料・デバイス」

■「次世代成長アプリとそれに搭載される電子デバイス」(11月1日午後、2日午前、午後)

「メディカル・ヘルスケア」、「ヒトに役立つロボティクス」、「マーケティング」

・「マーケティング」は、泉谷渉氏(NEDIA理事・副会長、(株)産業タイムズ社代表取締役社長)の司会によるエレクトロニクス産業・半導体産業・電子部品業界・液晶業界を網羅したパネルディスカッション形式で行います。

■「チュートリアル」

①「大学セッション」、[今さら聞けない半導体基礎講座]、「今さら聞けない半導体基礎講座②」

②スマホ・ウェアラブル機器に最適な先端超小型電子部品の現状

「超小型部品を支える最新材料・装置」、「超小型モジュール・電子部品」、「超小型電子部品の最新実装技術」

【展示会及びポスター展示】(11月1日 13:00-17:00、11月2日 10:00-17:00)

ホワイエでの展示会を17ブースで行います。また小会議室でも小規模のポスター展示会を予定しています。(無料でご覧いただけます)

【レセプション】(11月1日)17:00-18:30:アトリウム

フォーラムの参加者及び展示会出展の登録者は無料で参加いただけます。レセプションのみの参加は、参加費：3,000円です。

【参加費】(単位：円) ※()内の金額は早割価格(9月30日まで)

	一般	NEDIA 会員 大学教職員	学生
1 セッション	15,000 (13,000)	12,000 (10,000)	2,000 (2,000)
1 Day バス (2 セッション)	23,000 (20,000)	17,000 (15,000)	2,000 (2,000)
2 Day バス (4 セッション)	40,000 (35,000)	28,000 (25,000)	4,000 (4,000)

【開催者】

口主催：一般社団法人日本電子デバイス産業協会(NEDIA)

口特別協力：電子デバイス産業新聞(株式会社産業タイムズ社)

口後援：経済産業省近畿経済産業局、京都府(予定)、
京都市(予定)、SEMI ジャパン(予定)

口協賛：IEEE 関西支部

【連絡先】一般社団法人日本電子デバイス産業協会事務局

TEL: 03-5823-4465、FAX: 03-5823-4475

E-mail: ddf.info@nedia.or.jp (第3回電子フォーラム京都専用のメールアドレス。)

【申込先】参加のお申し込みは、

申込特設サイト：https://www.nedia.or.jp/ddf2016_entry/からお願い致します。特設サイトは、NEDIAHP：<http://www.nedia.or.jp>からも入ることができます。